

# TPCA 2026 異質整合 XPCB 趨勢眺望論壇-高雄專場

## AI 浪潮下電子供應鏈的技術變革與挑戰

隨著 AI、高效能運算 (HPC) 與先進封裝快速發展，全球電子產業供應鏈正迎來新一波重構浪潮。從晶片封裝、載板、材料到設備製程，AI 不僅改變終端應用需求，更全力加速推動供應鏈朝向高階化、在地化與協同化發展。在政府推動「大南方新矽谷」與「半導體 S 廊帶」的政策引領下，南台灣的半導體與先進封裝聚落快速成形，已成為全球 AI 供應鏈的重要核心之一。

為實踐在地化服務，TPCA 特別針對中南部會員規劃異質整合 XPCB 趨勢眺望論壇-高雄專場。本次研討會緊扣 AI 帶動的封裝、材料與設備發展方向，邀請來自日月光、同欣、麥德美與蘇州維嘉科技，共同分享 AI 浪潮下的供應鏈變化與技術挑戰。我們期盼透過更貼近產業聚落的對話平台，強化南部 PCB 與半導體供應鏈間的實質鏈結，協助業界即時掌握市場脈動、建立在地合作機會，共同迎接 AI 時代帶來的新商機與新挑戰！

**席次有限，誠摯歡迎產業先進把握難得機會，踴躍報名參加！**

【主辦單位】台灣電路板協會 (TPCA)

【贊助單位】阿托科技、長興材料 **誠摯邀請更多贊助企業夥伴加入!!** [點我看贊助方案](#)

【活動時間】2026.07.31 (五) 14:00-16:30

【活動地點】高雄漢來大飯店 9 樓金寶廳 (高雄市前金區成功一路 266 號)

【報名註冊】TPCA 所屬會員公司免費，非會員註冊費 2000 元 (網路報名至 7/24 日，額滿提早關閉)

【活動議程】

議程規劃	內容	講師
13:30-14:00(30')	報到	
14:00-14:02(2')	協會服務簡介、贊助商介紹	
14:03-14:05(3')	會議主席 開場致詞	TPCA 構裝委員會 黃智堯
14:05-14:35(30')	AI 封裝趨勢 (TBC)	日月光 資深處長 黃敏龍
14:35-15:05(30')	AI 需求下的陶瓷 Core 機會	同欣電子 研發經理 施建宇
15:05-15:20(15')	茶歇	
15:20-15:40(20')	AI 浪潮下的 PCB 加工及檢測系統創新實踐	維嘉科技 臺灣業務運營總監 蔡明煌
15:40-16:10(30')	脈衝電鍍技術在 IC 載板製備中的作用研究	麥德美封裝載板業務線總監 王興平
16:10-16:30(20')	Panel Discussion	主持人：TPCA 構裝委員會 黃智堯 與談人：黃敏龍、施建宇、蔡明煌、王興平

\*主辦單位保留議程變更之權利

**【付款方式說明】**

付款可選擇信用卡線上刷卡、轉帳匯款。轉帳完成者請務必提供帳號後五碼至註冊聯絡窗口方便對帳。

銀行：土地銀行(代碼: 005)北桃園分行

帳號：131-001-00069-9

戶名：台灣電路板協會

**【退費說明】**

方式	主辦單位取消	報名者自行取消 活動前三天(含 7/28)前告知	時間
匯款	全額退還對方已繳費用 TPCA 需負擔匯款手續費	報名者需負擔 TPCA 匯款手續費後退回剩餘款項	以土銀匯款退費 每月 20 號前請款，月底退還
刷卡	刷退方式處理	刷退方式處理	確認取消後，2 日內完成刷退

**無法退費說明:活動前兩工作天至活動當天取消且已完成繳費者，恕無法退費。**

**【活動窗口】**黃瑜琦 (T) 03-3815659 #405 (F) 03-3815150 (E) [mickey@tpca.org.tw](mailto:mickey@tpca.org.tw)

**【報名窗口】**蔡逸鴻 (T) 03-3815659 #402 (F) 03-3815150 (E) [owen@tpca.org.tw](mailto:owen@tpca.org.tw)